

2022年8月10日

各位

会社名 株式会社倉元製作所
代表者名 代表取締役社長 宮澤 浩二
(コード番号 5216)
問合せ先 取締役 小峰 衛
電 話 0228 - 32 - 5111

新たな事業の開始に関するお知らせ

当社は2022年8月10日開催の取締役会において、新たに半導体加工事業を開始することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 事業開始の趣旨

当社の主力事業である基板加工事業はコスト低減等により業績は改善しておりますが、国内ディスプレイ市場は縮小傾向が見込まれます。このため、今後、基板加工事業だけで安定的な収益を確保することが難しいことから当社の研磨加工技術を活かし安定的な収益を確保していくために半導体加工事業を開始することといたしました。

2. 新たな事業の概要

(1) 当該事業の内容

半導体加工事業では、今後拡大が見込まれるパワーデバイス市場で使用されるSiC(注1)ウェハやSiCパーツの研削・研磨加工をいたします。

(注1) SiC(シリコンカーバイド)はシリコン(Si)と炭素(C)で構成される化合物半導体材料です。

(2) 当該事業を担当する部門 事業部

(3) 当該事業の開始のために特別に支出する金額及び内容 固定資産取得費等として203百万円を見込んでおります。

3. 日程

取締役会決議日 2022年8月10日
事業開始日 2022年11月(予定)

4. 今後の見通し

本件が2022年12月期の当社業績に与える影響は軽微であります。今後、業績に重要な影響を与える見込みが生じた場合には、速やかにお知らせします。

以上